

ULVAC

株式会社 アルバック

決算説明資料

2021年度 第2四半期 2021年7月~2021年12月

2022年2月15日

証券コード：6728

Breakthrough 2022

将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。

世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

1. 21年度上期 連結業績概要

受注高・売上高・営業利益は前年同期比大幅増加

- 営業利益率：10.8%に改善（前年同期比+3.8pt）
- 売上総利益率(第2四半期)：32.4% ⇒モノづくり力強化等により上場来最高水準
- 通期受注高2,450億円（計画比+150億円）に見直し

	上期実績	前年同期比	計画比
□受注高	1,446億円	+536億円 +59%	+376億円 +35%
□売上高	1,057億円	+218億円 +26%	+97億円 +10%
□営業利益	114億円	+56億円 +95%	+24億円 +27%

2. アルバックを取り巻く環境

半導体・電子・FPD投資市場は中長期的に拡大継続

- 上期受注は好調（前年同期比：半導体1.7倍、電子1.2倍、FPD2.4倍）

3. 中期経営計画の進捗：順調

- 開発力強化・成長事業強化 ⇒半導体・電子・FPDの受注増加
- モノづくり力強化により利益率改善



2021年度上期 連結業績概要

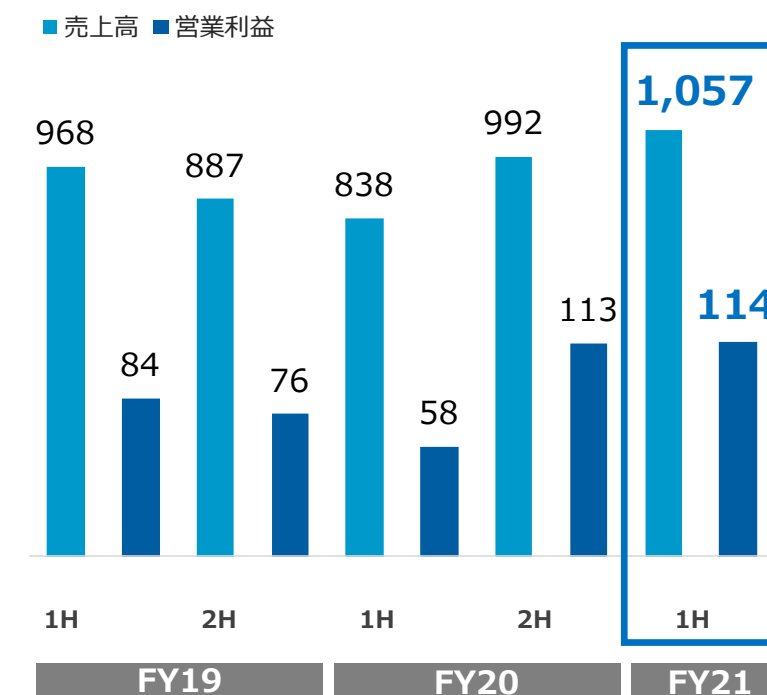
1. 2021年度上期業績概要

- 受注高：半導体・電子投資拡大等により、前年同期比**59%増**
- 売上高：前年同期比**26%増**、営業利益：前年同期比**95%増**
- 営業利益率：**10.8%**（前年同期比**+3.8pt**）に改善（下期は更に改善見込み）

【単位：億円】	2020年度 上期	2021年度 上期				
	実績	計画	実績	前年同期比	計画比	
受注高	910	1,070	1,446	+536	+59%	+376
売上高	838	960	1,057	+218	+26%	+97
売上総利益	233	-	321	+88	+38%	-
率	27.8%	-	30.4%	-	+2.6pt	-
販管費	175	-	207	+32	-	-
営業利益	58	90	114	+56	+95%	+24
率	7.0%	9.4%	10.8%	-	+3.8pt	+1.4pt
経常利益	60	90	120	+60	+100%	+30
率	7.2%	9.4%	11.4%	-	+4.2pt	2.0pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益	45	65	81	+36	+79%	+16
率	5.4%	6.8%	7.7%	-	+2.3pt	+0.9pt

売上高と営業利益の推移

【単位：億円】

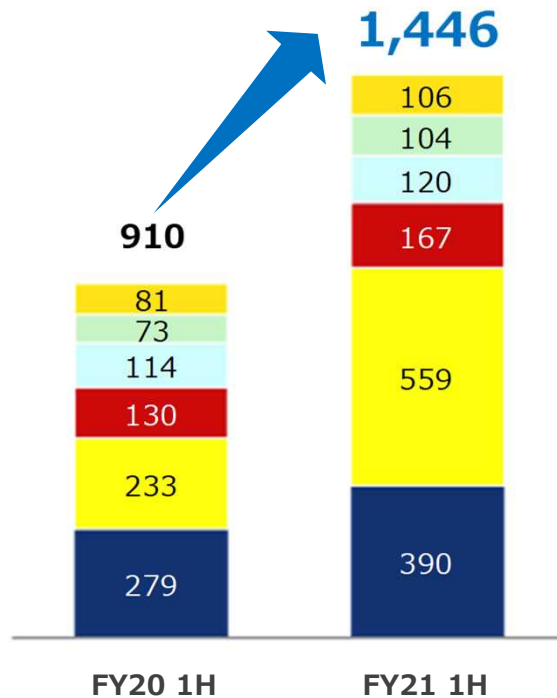


1-(1) 品目別受注高・売上高：投資活発化により大幅増加

- 半導体・電子・FPDの投資活発化により、前年同期比大幅増加

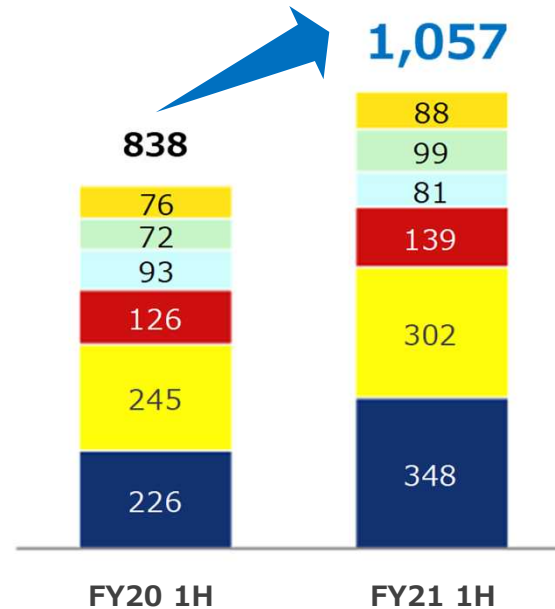
受注高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



売上高 【単位：億円】

■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント ■ 材料
■ FPD製造装置 ■ 一般産業用装置 ■ その他



受注高

- **半導体**：ロジック・メモリともに投資活発化、前年同期比**1.7倍**
- **電子**：パワーデバイス・各種電子デバイス等中心に増加、前年同期比**1.2倍**
- **FPD**：前倒し発注（約200億円）により、通期計画の8割超を上期受注（前年同期比**2.4倍**）

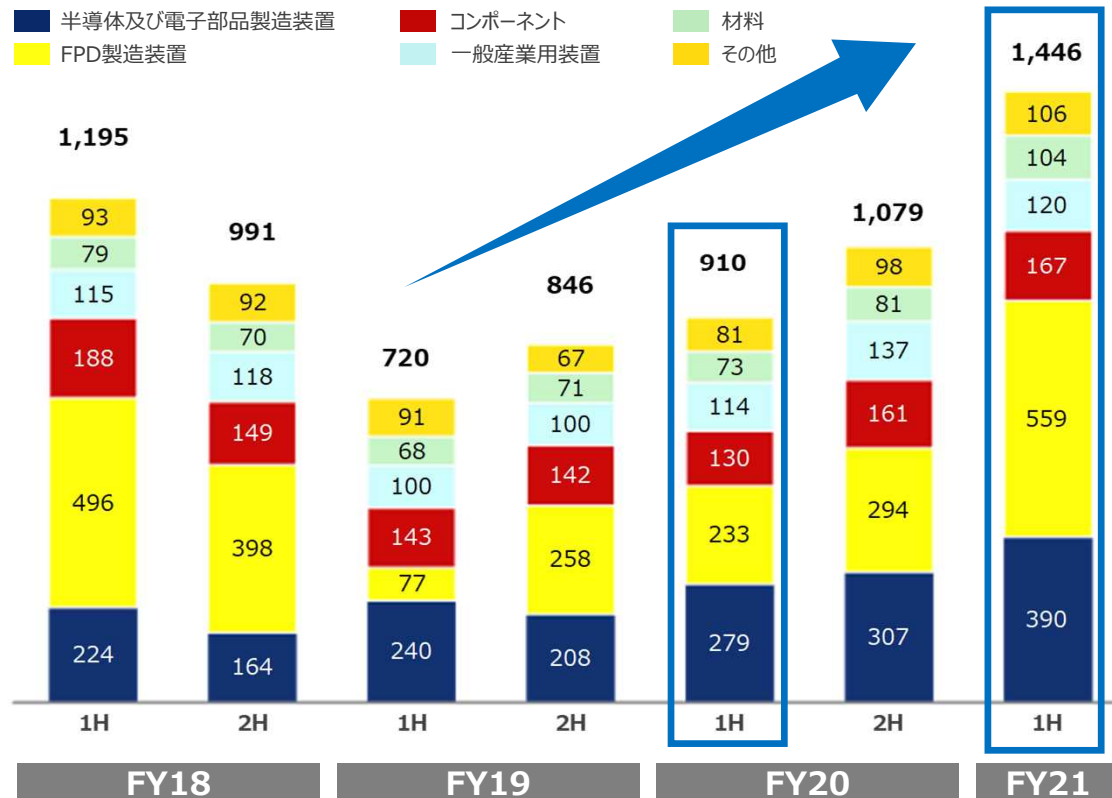
売上高

- 半導体・電子・FPD中心に前年同期比増加（部品長納期化の影響で売上貢献にタイムラグ）

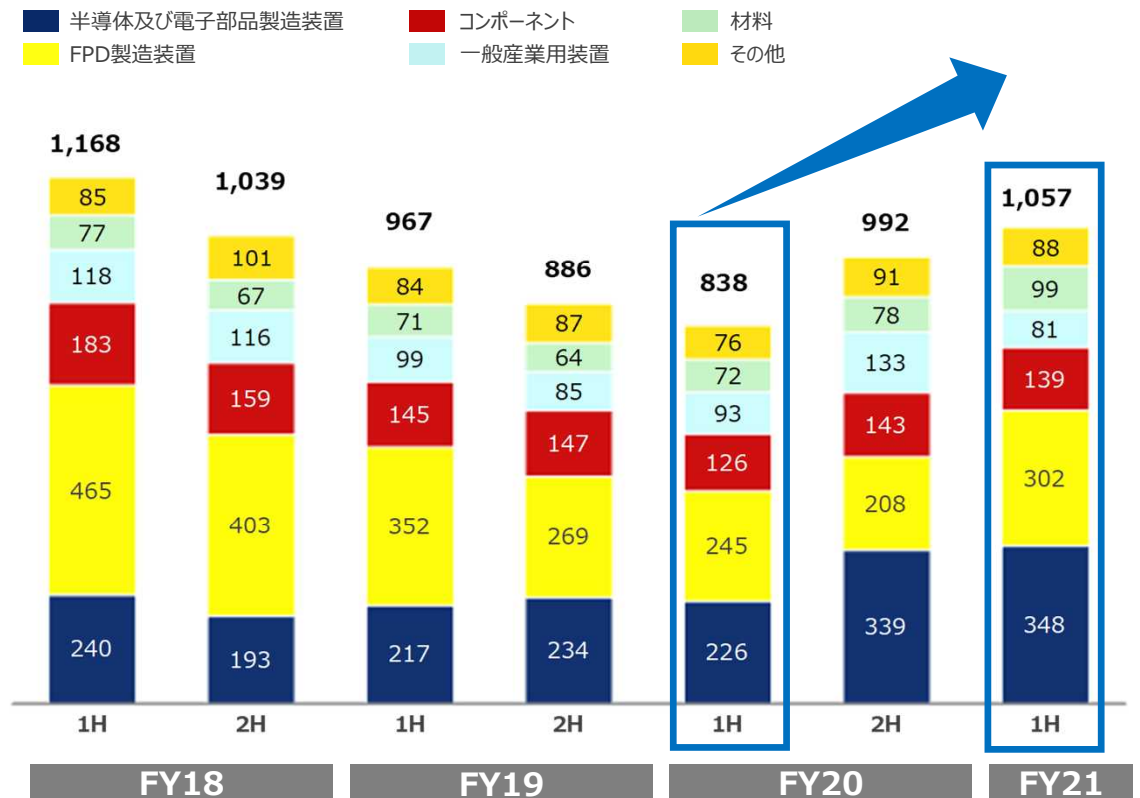
1-(2) 品目別受注高・売上高推移：半導体・電子は計画を上回る成長

- 半導体・電子：中期経営計画を上回る成長
- FPD：LCD投資増で上期大幅増加
- 受注残高増加により来期以降の売上に貢献

受注高 【単位：億円】



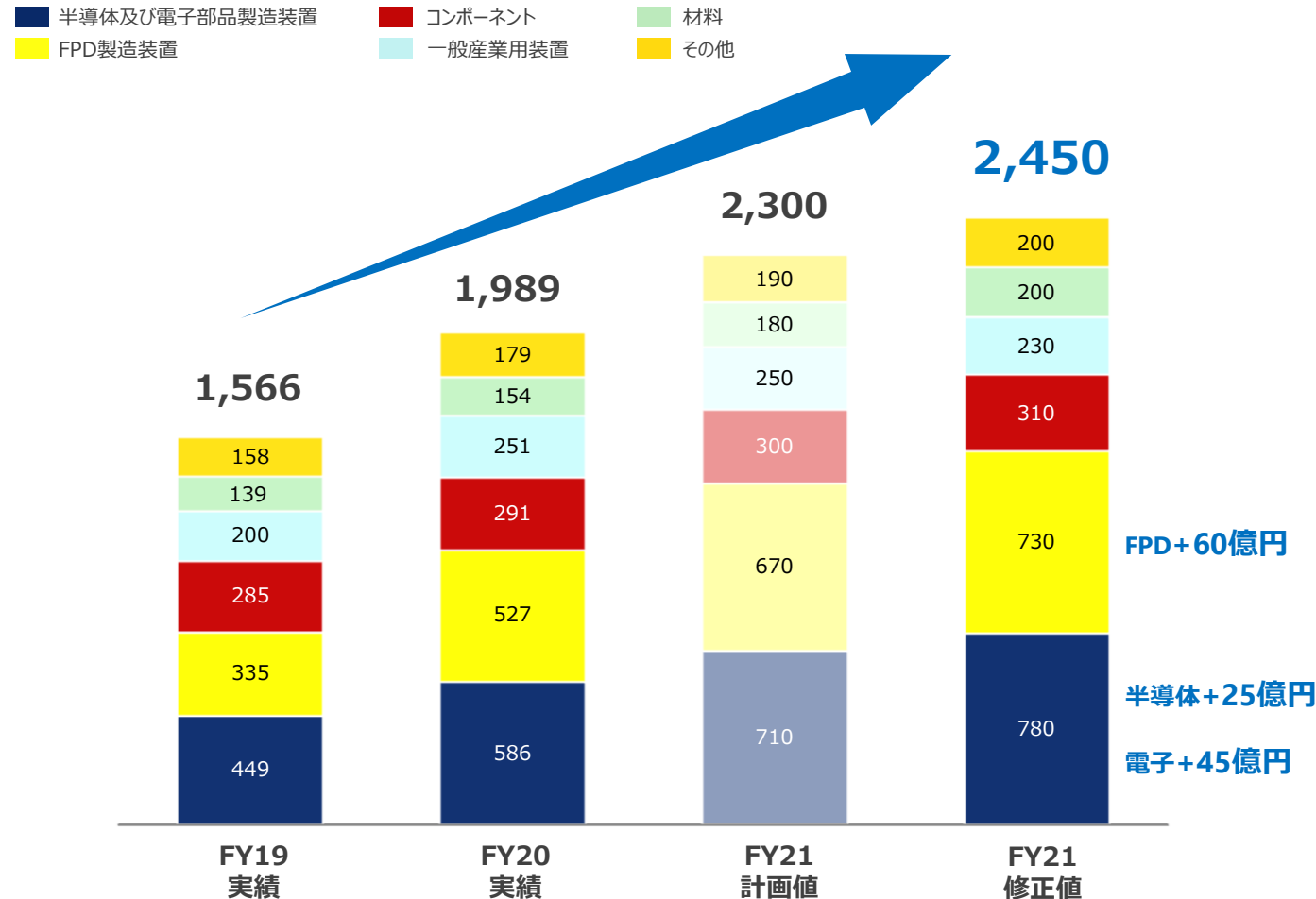
売上高 【単位：億円】



2. 通期受注計画見直し：2,450億円（+150億円）に見直し

- 半導体・電子・FPDの投資活発化により通期受注計画を2,300億円から2,450億円（+150億円）に見直す
- 半導体・電子を中心に更なる成長を目指す（来期計画は8月に開示予定）

【単位：億円】



半導体：前年同期比**1.5倍**

- **ロジック**（前年同期比**2.2倍**）・**メモリ**（前年同期比**1.3倍**）投資活発化

電子：前年同期比**1.2倍**

- **パワーデバイス**（前年同期比**1.5倍**）・**中国投資活発化**

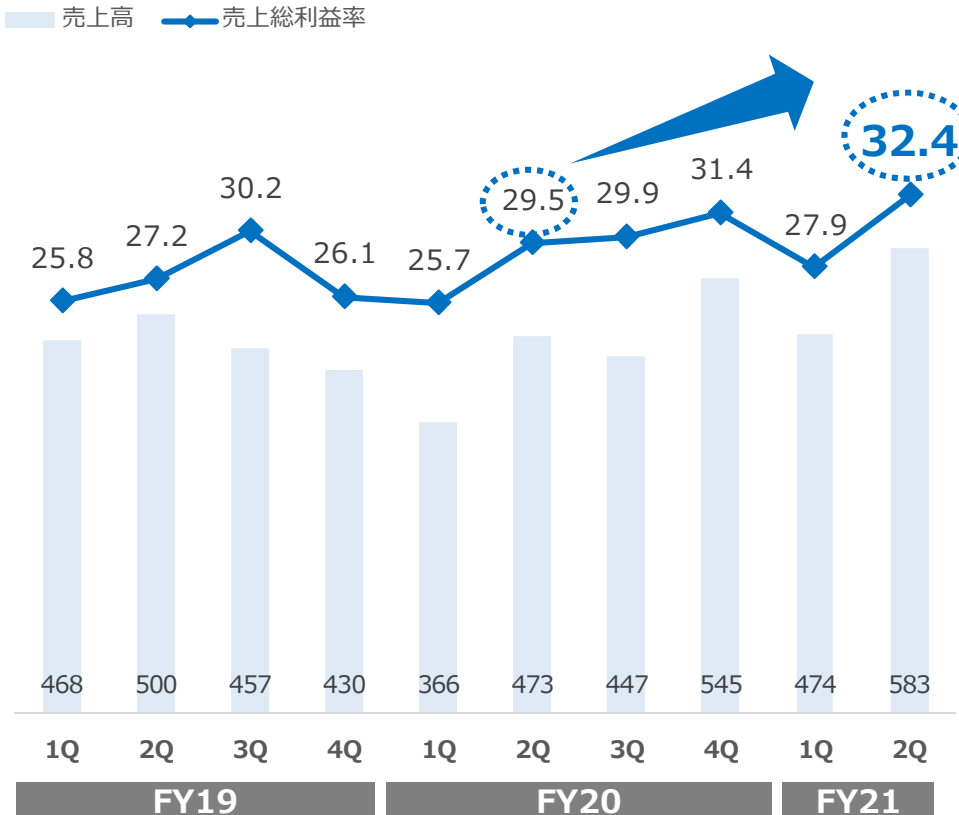
FPD：前年同期比**1.4倍**

- **LCD投資活発化**
- 来年度以降も、**ITパネル向け投資・OLED化投資（大型基板）の継続、EVバッテリー投資（23年度以降本格化）**を見込む

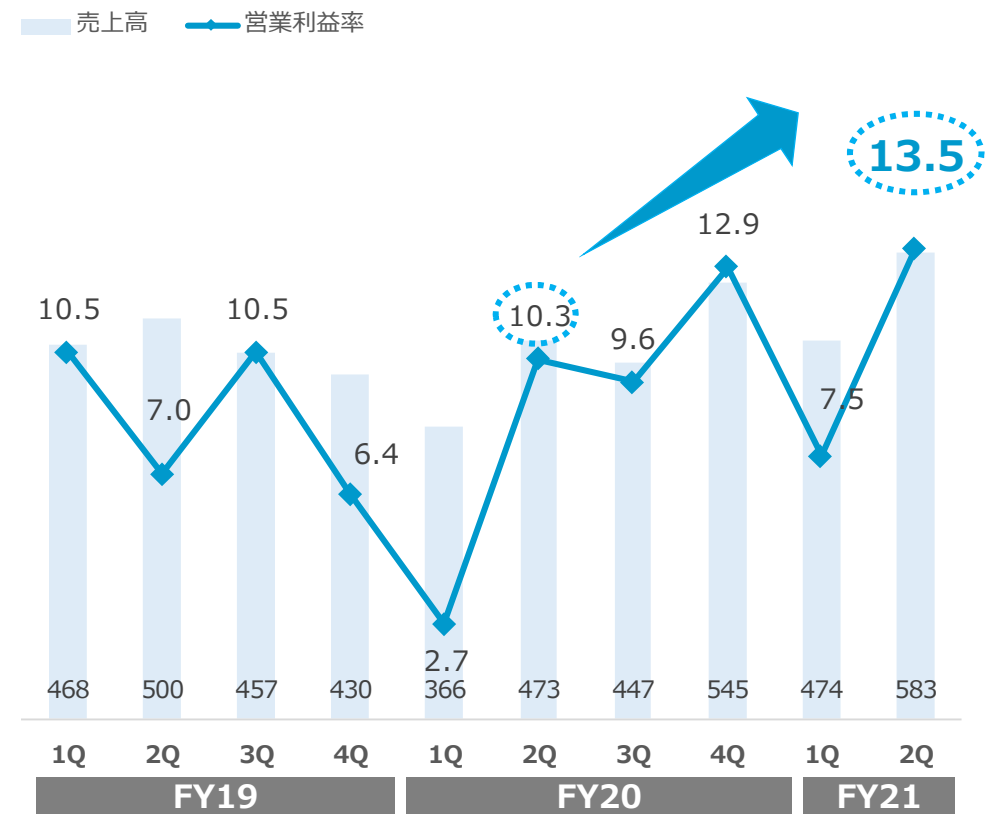
3-(1) 第2四半期利益率：売上総利益率は上場来最高水準

- 売上総利益率：32.4% 上場来最高水準
- 営業利益率：13.5% 前年同期比大幅改善

売上総利益率 【単位：億円、%】



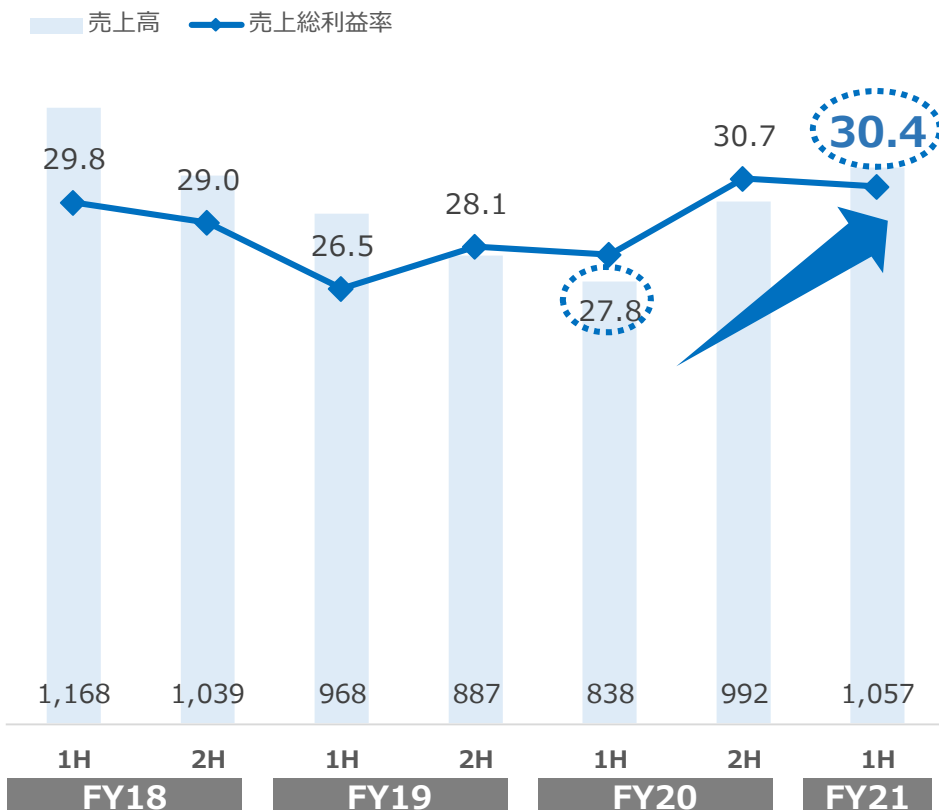
営業利益率 【単位：億円、%】



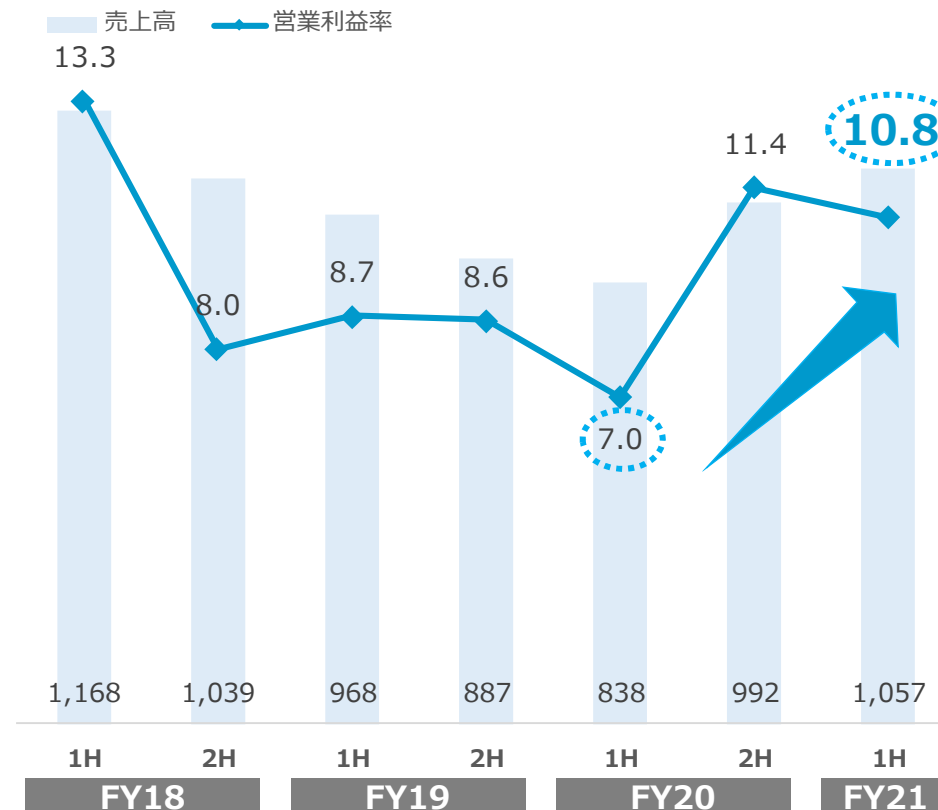
3-(2) 上期利益率：前年同期比改善

- 売上総利益率・営業利益率とも改善
- 下期利益率はモノづくり力強化により更に改善見込み

売上総利益率 【単位：億円、%】



営業利益率 【単位：億円、%】





アルバックを取り巻く環境



中長期的に投資拡大継続

スマート社会化・デジタル化進展

技術革新投資



メタバース



グリーンエネルギー化

増産投資

地域サプライチェーン構築 (各国補助)

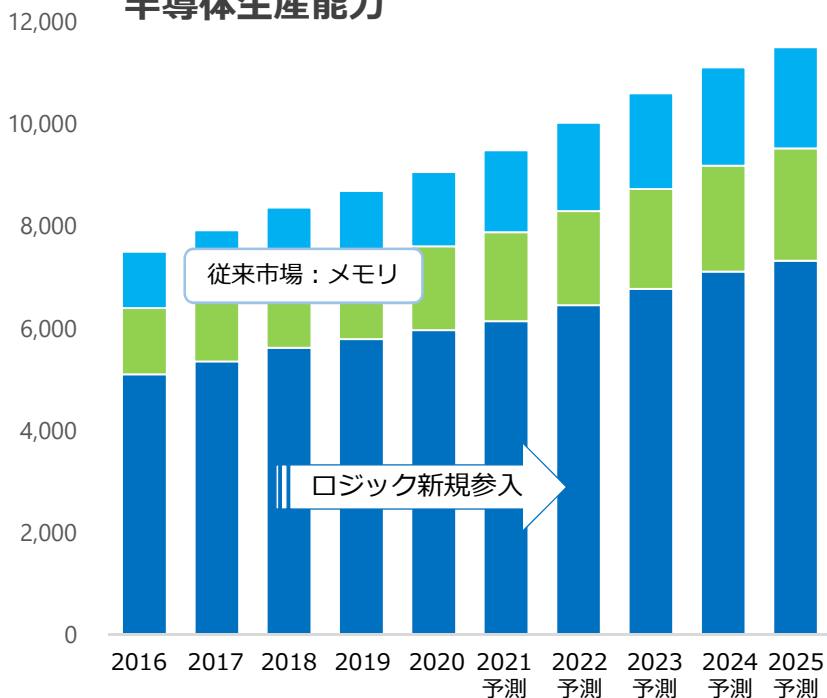
1-(1) 半導体：ロジック参入でビジネスチャンス拡大

- ロジック：メタル・ハード・マスク（MHM）工程参入でビジネスチャンス拡大
- **ロジックとメモリの両輪で成長実現**
- **ロジック市場の伸びを上回る成長（MHM・他工程）**

ロジック参入でビジネスチャンス拡大

■ Logic ■ NAND ■ DRAM [k/month]

半導体生産能力

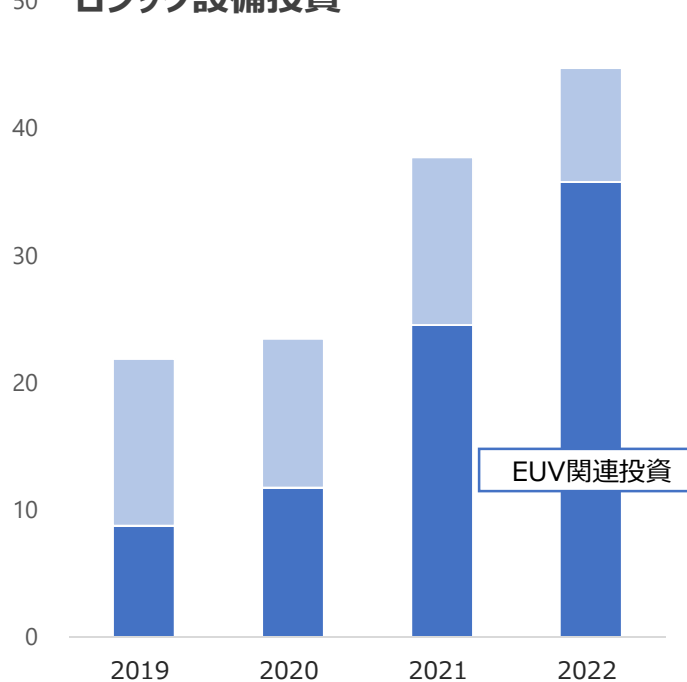


出所：SEMI等をもとに当社予測

EUV関連投資拡大：8割

■ EUV関連投資 ■ 汎用ロジック投資 【単位：bnUS\$】

ロジック設備投資



出所：SEMI,各社投資計画等をもとに当社予測

ロジック・ファウンドリー投資

- ロジック・ファウンドリー、メモリともに微細化・積層化など技術革新を伴う生産能力増強積極化
- **EUVのMHM工程でデファクトスタンダード**
⇒他工程でもビジネスチャンス拡大（セカンドベンダー期待大）

EUV関連投資拡大・市場を上回る成長

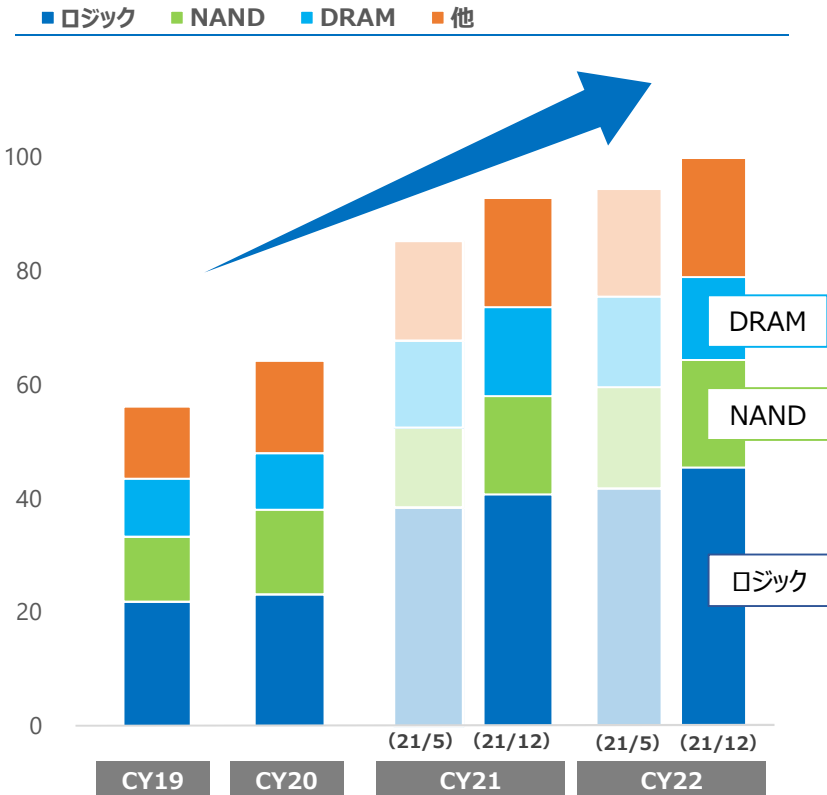
- ロジック・ファウンドリーメーカーの**最先端投資はEUV関連（ロジック投資の約8割）**
- **ロジック設備投資増（19年比21年1.7倍）に対し受注は2.8倍と市場の伸びを大きく上回る成長**
⇒MHM設備投資増・新規取引開拓・他工程参入で市場を上回る成長を目指す

1-(2) 半導体：市場を上回る成長

- ロジック、メモリともに設備投資拡大継続
- ロジック MHM工程増加 + 他工程増加で市場を上回る成長

半導体設備投資予測

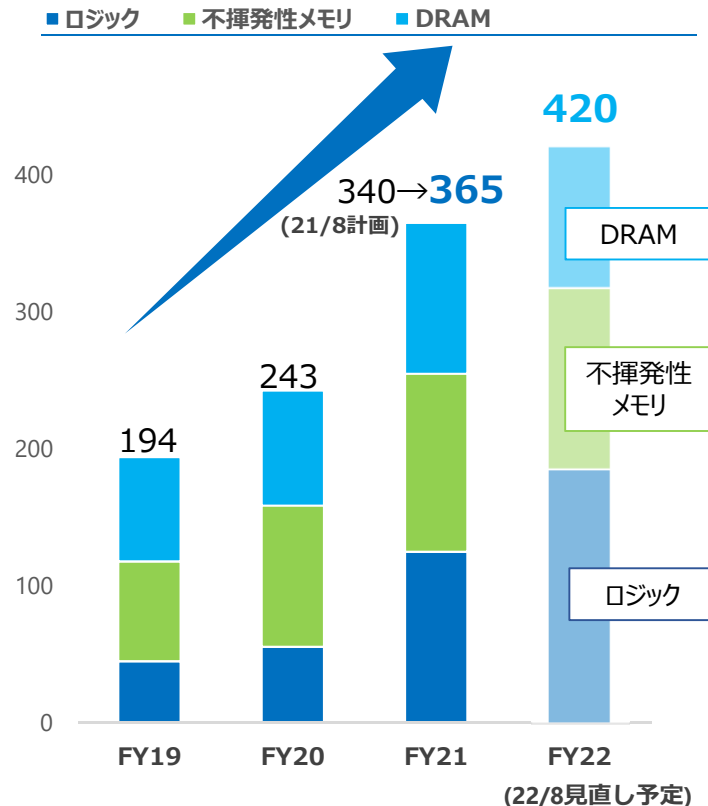
【単位：bnUS\$】



出所：SEMI

受注計画

【単位：億円】



投資動向

- 5G、IoT、AI、メタバースなどアプリケーションのすそ野拡大・高機能化
データトラフィック増に伴うデータセンター投資
⇒半導体投資は中長期的に拡大基調
- 22年度も設備投資拡大

受注動向

- 上期：ロジック（前年同期比1.9倍）、メモリ（前年同期比1.6倍）ともに増加
- 下期：上期並みの高水準受注を見込み、通期では計画を上回る365億円（前年同期比1.5倍）見込み
- ロジック関連中心に成長を見込む

2-(1) 電子：多様な電子デバイス分野・アプリケーション向け装置ラインアップ **ULVAC**

	最終用途	デバイス
 <p>パワーデバイス</p>	EV車載デバイス インバータモータ 産業用ロボット 省電力機器  	IGBT SiC ダイオード MOSFET
 <p>オプトデバイス</p>	AR/VR 車載用インパネ 3Dセンサー  	μ OLED 反射防止膜 バンドパスフィルター
 <p>通信デバイス</p>	スマートフォン 無線基地局  	SAW・BAWフィルター RFデバイス
 <p>実装</p>	PC スマートフォン データサーバ IoTデバイス  	FanOut WLP・PLP Info-package
 <p>電子部品 (MEMS)</p>	指紋認証 LiDAR  	Piezo-MEMS



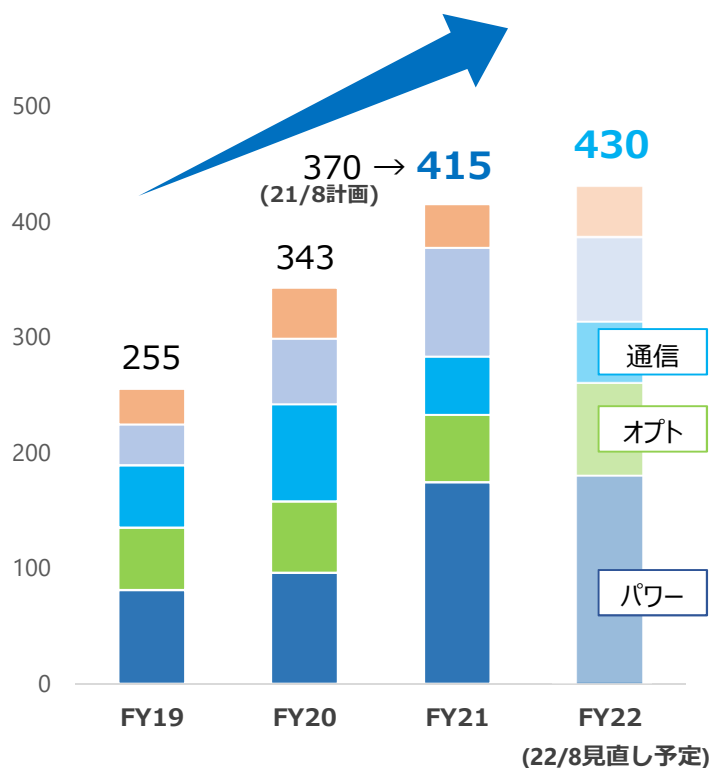
2-(2) 電子：中国中心に日本・台湾等で成長

- パワーデバイス、オプトデバイス、通信デバイス等の投資が日本・中国を中心に活発化
- 特に中国は政府の国産化方針もあり、パワーデバイス中心に投資活発化

受注計画（分野別）

【単位：億円】

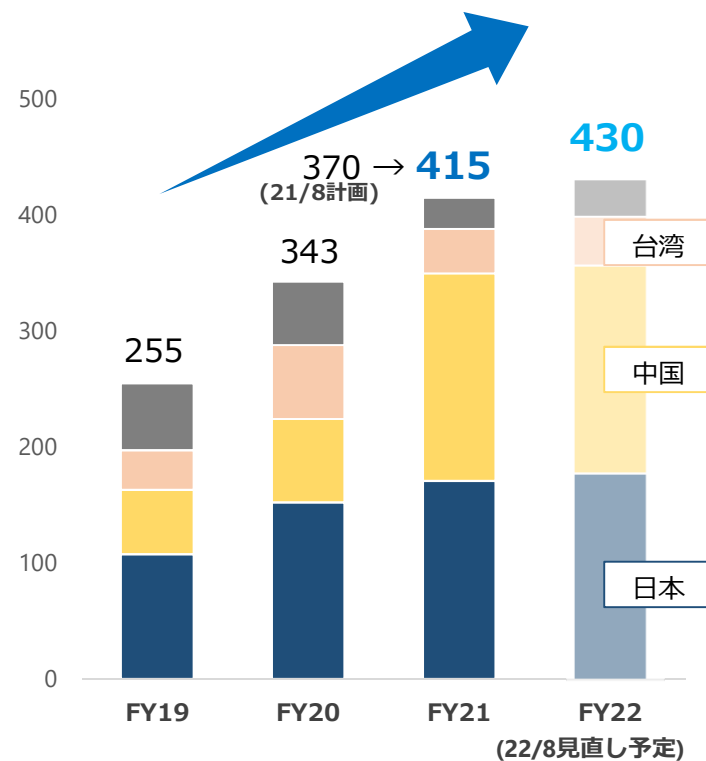
- パワーデバイス
- オプトデバイス
- 通信デバイス
- 電子部品（MEMS）
- パッケージング



受注計画（地域別）

【単位：億円】

- その他
- 台湾
- 中国
- 日本



投資動向

- 新エネルギーシフト（グリーン化）、デジタルインフラ建設、メタバースなどの新しいアプリケーション拡大に伴い、各種デバイスの技術革新進展・需要増加
⇒設備投資活発化
- 中国国産化政策、地方政府支援で新規参入増加
⇒沿海部中心に電子デバイス工場建設増加

受注動向

- 上期：パワーデバイス・通信デバイス・センサ等中心に増加
- 下期：パワーデバイス・オプトデバイス等を中心に高水準
- 通期：計画を上回る415億円（前年同期比1.2倍）を見込む
- 引き続きパワーデバイス、オプトデバイス（AR・VR向けμOLED等）、通信デバイス（SAW/BAWフィルター）等の投資活発化に対応して成長

2-(3) 電子成長要因：パワーデバイスはグリーンエネルギー化・EV化で成長

- グリーンエネルギー化・EV化進展等に伴いパワーデバイスが成長エンジンに（上期受注：前年同期比1.4倍）

市場環境

アルバックの強み

IGBT

高電圧・大電流

- EV化に伴うパワーデバイス搭載数増加
- 日系主要各社による積極投資

- 裏面電極用スパッタ装置で高いシェア
- 日系主要各社との豊富な実績

SiC

高電圧・大電流

- 【中国】
- グリーンエネルギー投資加速
- 国産化方針・地方政府支援
- SiCウェハー生産増強

- 【中国】
- SiC用イオン注入装置シェア7割以上
- 10年前から中国企業の量産化サポート
- エンジニア派遣常駐による技術営業力

Si-MOSFET

低電圧・低電流

- 【中国】
- 家電製品等のインバーター化
- 国産化方針・地方政府支援
- Low～Midエンド機器の需要旺盛

- 【中国】
- 現地生産による価格競争力
- 現地設計によるカスタマイズ対応
- サプライチェーン体制構築

電子デバイス需要増加・輸入依存

- ・パワーデバイス
- ・高周波デバイス



中国国産化方針

- ・サプライチェーンの安定化
- ・貿易収支改善

地方政府支援（各種優遇・支援）

新エネルギーシフト（グリーン化）

- ・再生可能エネルギーシフト
- ・新エネルギー車増加
- ・LiB生産量増加

デジタルインフラ建設

- ・5G基地局
- ・データセンター

沿海部を中心に電子デバイス工場建設増加



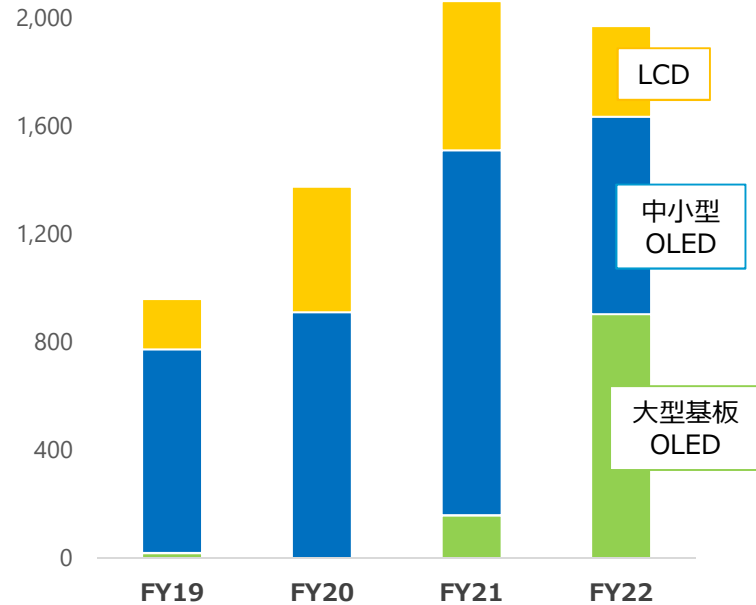
3. FPD : 上期受注増加、中長期的にはOLED化・バッテリー関連が牽引

- 上期 : ITパネル向けLCD投資活発化。LCD・OLEDともに受注大幅増
- OLED化進展 (モバイル+ITパネル+TV) ⇒22年度以降大型基板 (G8.5) OLED投資活発化
- 23年度以降EVバッテリー向け巻取式蒸着装置も寄与

FPD設備投資動向 (蒸着・スパッタ)

【単位：億円】

■ OLED大型 ■ OLED小型 ■ LCD

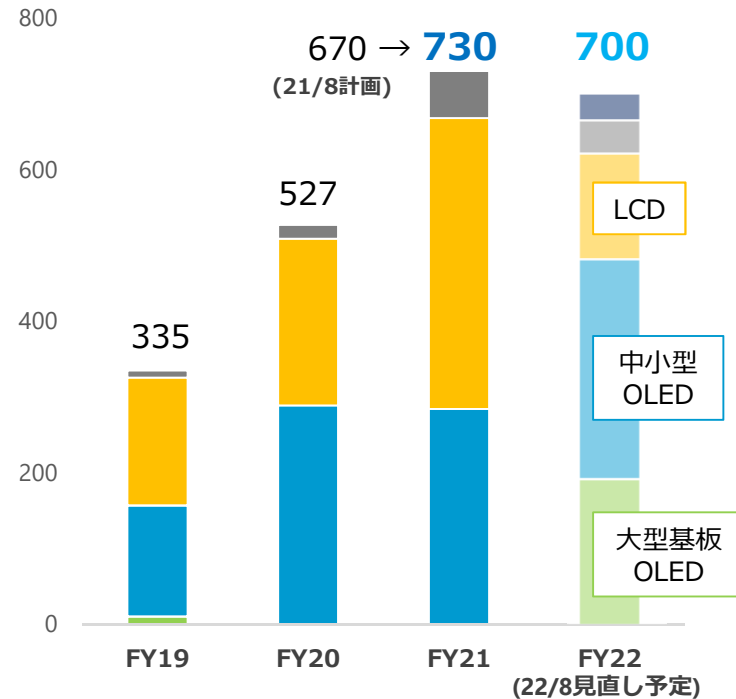


出所：当社予測

受注計画

【単位：億円】

■ 大型基板OLED ■ 中小型OLED ■ LCD
■ キャパシタ・バッテリー ■ その他



投資動向

- ITパネル向け (タブレット・PC・医療用・車載用・ゲーム用など) の高精細・広視野角LCD投資活発化
- OLED化進展 (モバイル+ITパネル+TV)
- EVバッテリーの小型大容量化・安全性向上に向けた巻取式蒸着装置開発

受注動向

- LCD・OLEDの前倒し発注増加(約200億円)、通期受注計画も60億円増加
- 22年度以降も、OLED化進展、EVバッテリービジネス等により700億円前後をベースとして見込む
- 大型基板OLEDは、大型基板スパッタリング装置や搬送技術、高精細対応での強みを活かす

コンポーネント

(上期：前年同期比**1.3倍**)

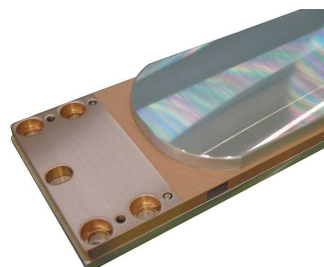


リークディテクター

- 半導体電子・FPD・民生機器関連の投資活発化により、受注好調
- 空調部品等の製品検査に使用されるリークディテクター（HELIOTシリーズ）好調
- 部品長納期化による受注前倒しも一部あり
- クライオポンプはOLED向けに加え、半導体・電子関連も堅調

マテリアル

(前年同期比**1.4倍**)



FPD製造装置向け
スパッタリングターゲット

- 半導体電子・FPD関連の装置稼働率上昇により、受注好調
- LCDパネルの高精細化（IGZO）、半導体電子の焼結ターゲット（W, WSi等）、メタルターゲット（Al, Ti）等を拡販

カスタマーサポート

(前年同期比**1.2倍**)



- 半導体電子・FPD関連の投資活発化・装置稼働率上昇に伴い、受注好調
- EV化加速により、車載キャパシタ関連も受注好調
- 高付加価値パネル化CIPビジネス拡大
- OLED用クライオポンプのオーバーホールビジネス拡大



中期経営計画の進捗

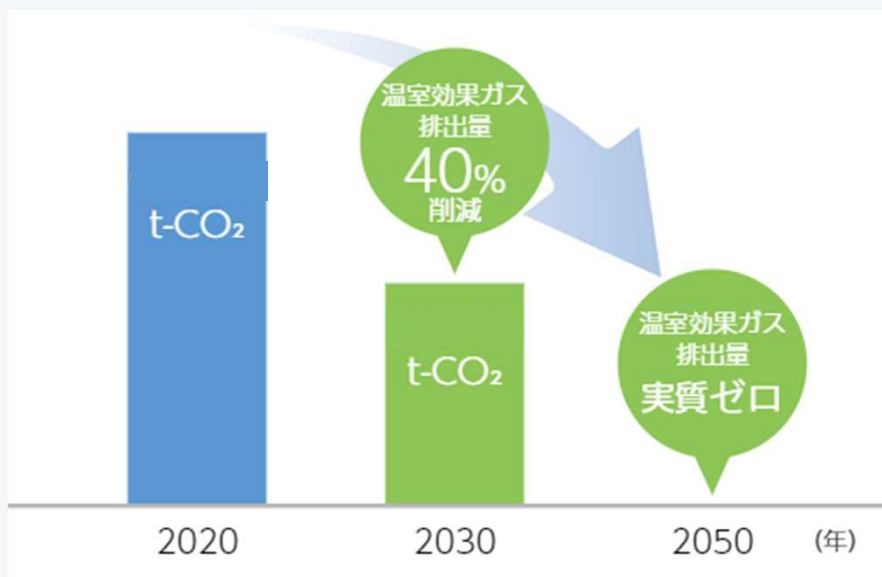
	中期経営計画の取り組み（計画）		成果・進捗評価	
成長事業の強化 研究開発力強化	半導体	ロジックの微細化工程新規参入 メモリ投資再開・新工程参入	ロジック・メモリ投資活発化⇒受注計画超過 MHM工程+他工程開発で成長	
	電子	モジュール化による提案装置拡大 中国での開発・営業・サポート体制強化	パワー・オプト・通信デバイス等の投資活発化 ⇒日本・中国を中心に受注計画超過 モジュール化「uGmniシリーズ」で提案装置拡大 中国営業・技術サポート体制強化で受注計画超過	
	FPD	大型基板OLED量産開発 利益体質に転換	LCD投資継続・OLED化で受注計画超過 モノづくり力強化・利益率改善を着実に実施	
モノづくり力強化	技術設計・調達・生産一体改革 ⇒生産性向上⇒利益率改善		各種施策を着実に実施⇒利益率も着実に改善 第2四半期売上総利益率は上場来最高水準に	
グループ経営効率強化	ビジネスユニット経営推進 自社製品を持つグループ会社の経営強化		韓国グループ会社統合 国内製造子会社2社の吸収合併決定 各社にて経営改革を推進	
経営基盤強化	人財育成・活性化		新人事制度導入・次世代リーダー育成	
	情報システム基盤強化		生産性向上に向けた各種システム整備を着実に実施	
	財務基盤強化		自己資本比率：56.1%	

環境目標の改定

国内外における省エネルギーに対する取り組み努力と、温室効果ガス排出量の少ない再生可能エネルギーの導入、環境配慮型製品の開発等あらゆる活動を通じて、温室効果ガス排出量抑制に努め、気候変動対策に取り組んでいきます。

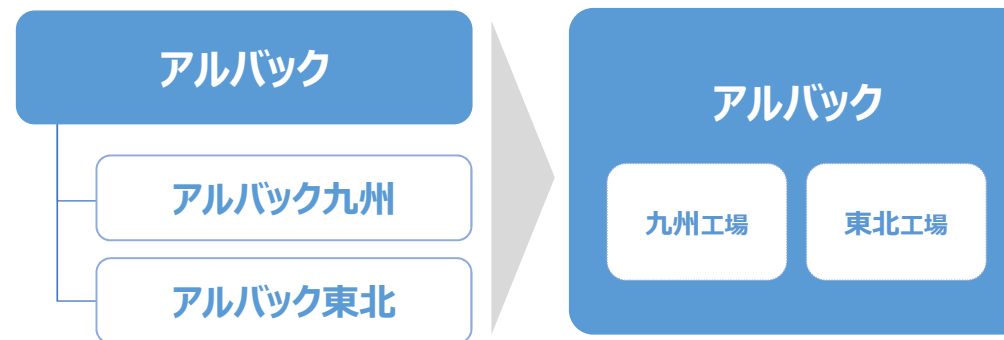
「温室効果ガス排出量目標」

- ① 2030年の温室効果ガス排出量を2020年比40%削減
- ② 2050年の温室効果ガス排出量実質ゼロ



完全子会社の合併

「モノづくり力強化」加速のため、国内主要製造子会社2社を吸収合併し、多種多様な製品生産技術を取り込み、生産性と利益率のより一層の向上を目指します。本合併は2022年7月に予定しています。



Value Report 2021発行

- サステナブル経営に関する開示を強化
- 人権・気候変動に関する取り組み
- 社外取締役の視点からみた当社価値創造



スマート社会・
デジタル社会実現



グリーンエネルギー化
低消費電力化

社会的課題解決

メモリ	ロジック IC	センサー	通信デバイス	バッテリー
微細化		高性能化		低消費電力化

スパッタリング	真空薄膜形成技術	コンポーネント
エッチング		マテリアル
真空蒸着		CVD



補足資料

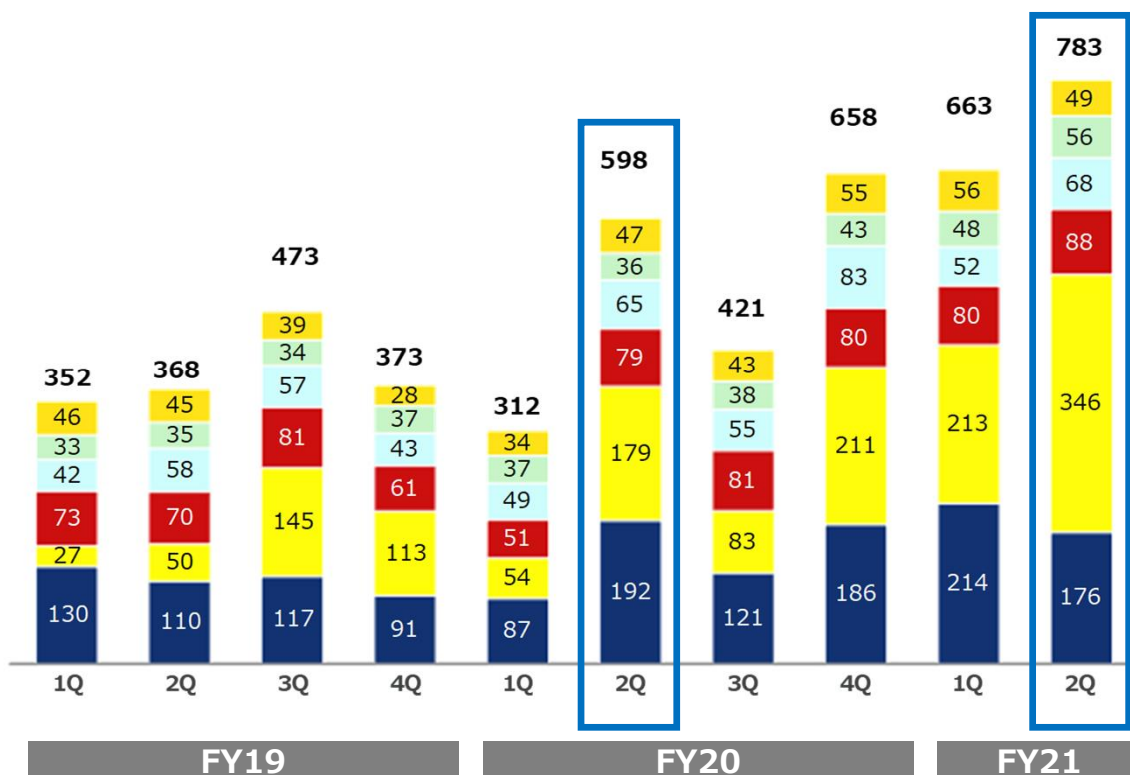
【単位：億円】

	2020年度				2021年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前年同期比	
							増減額	増減率
受注高	312	598	421	658	663	783	+185	+31%
売上高	366	473	447	545	474	583	+110	+23%
売上総利益	94	139	134	171	132	189	+50	+36%
率	25.7%	29.5%	29.9%	31.4%	27.9%	32.4%	-	+3.0pt
販管費	84	91	90	101	97	110	+20	+22%
営業利益	10	49	43	70	36	78	+30	+61%
率	2.7%	10.3%	9.6%	12.9%	7.5%	13.5%	-	+3.2pt
経常利益	10	50	41	78	35	85	+35	+70%
率	2.8%	10.6%	9.2%	14.4%	7.4%	14.6%	-	+4.1pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益	3	42	37	66	22	59	+17	+40%
率	0.9%	8.9%	8.3%	6.7%	4.7%	10.1%	-	+1.2pt

品目別受注高・売上高推移（四半期）

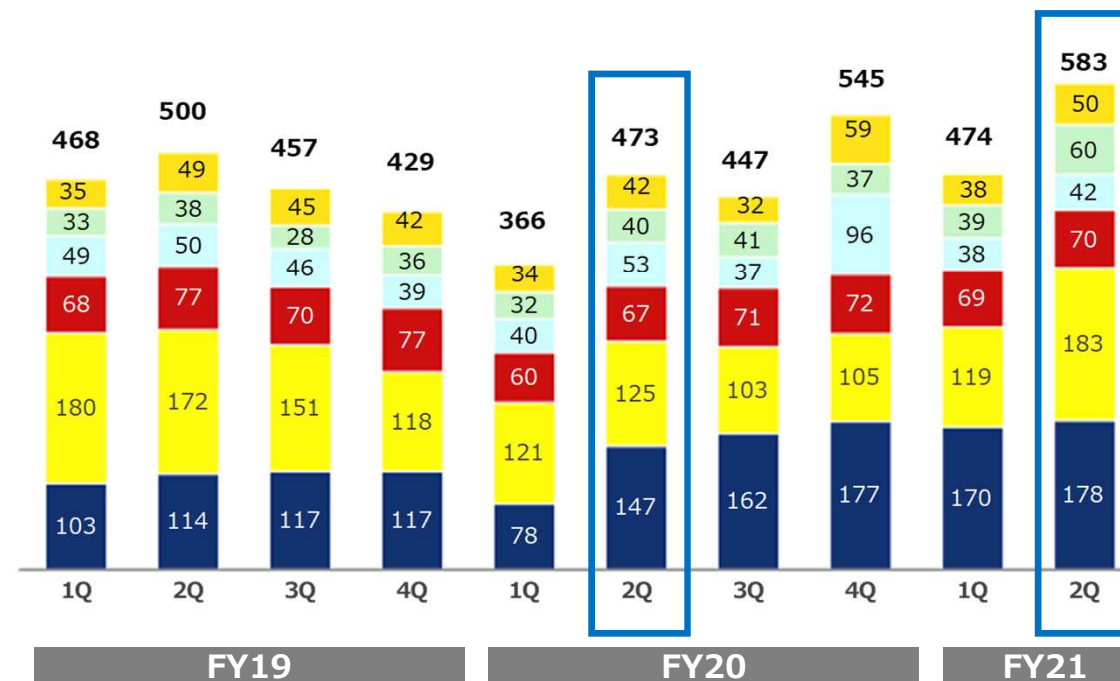
受注高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



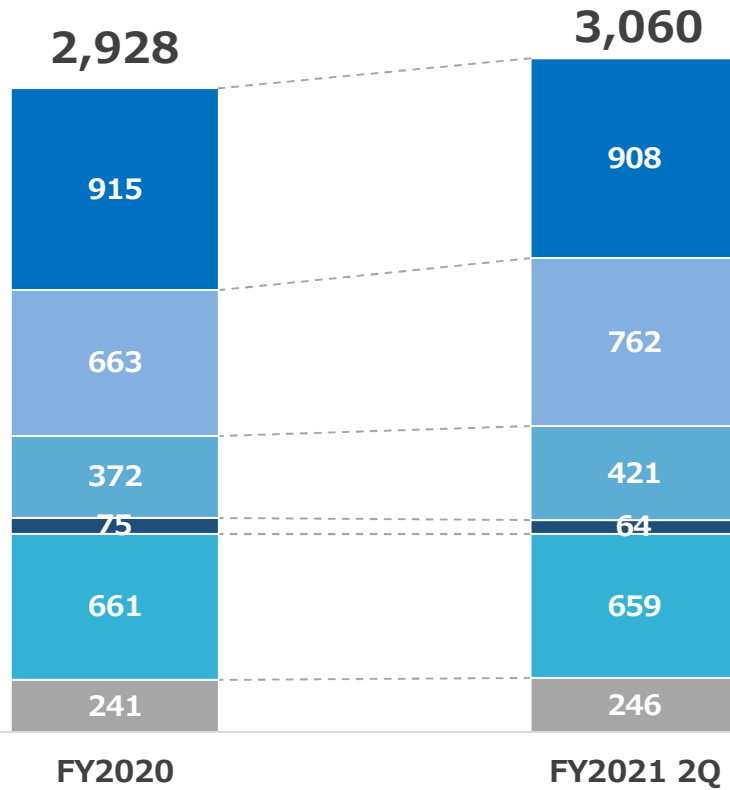
売上高 【単位：億円】

- 半導体及び電子部品製造装置
- コンポーネント
- 材料
- FPD製造装置
- 一般産業用装置
- その他



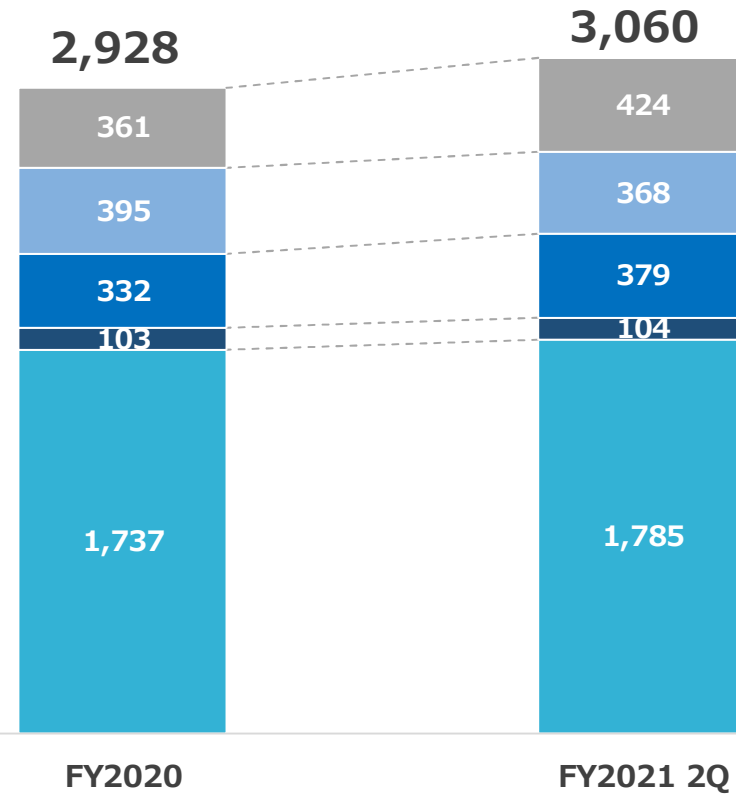
資産 【単位：億円】

- 投資有価証券 他 ■ 有形固定資産 ■ その他の流動資産
- 棚卸資産 ■ 受取手形・売掛金 ■ 現金・預金



負債・純資産 【単位：億円】

- 純資産 ■ その他固定負債 ■ その他流動負債
- 有利子負債 ■ 支払手形・買掛金



さまざまな業界・用途で貢献する アルバックの真空技術



ULVAC